

EMC电子封装高填充球形硅微粉

产品名称	EMC电子封装高填充球形硅微粉
公司名称	安徽壹石通材料科技股份有限公司上海分公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:壹石通Estone 型号:SJS 产地:安徽怀远
公司地址	上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）（注册地址）
联系电话	15221974640 17317852016

产品详情

EMC电子封装高填充球形硅微粉

目前，在电子封装材料环氧模塑料（EMC）行业，要满足环保的要求，达到环境认证的指标，提高EMC中硅微粉的填充量是有效的途径之一，国际上球形硅微粉在EMC中的最高填充率已达90%以上。

球形二氧化硅粉是指颗粒个体呈球形，主要成分为二氧化硅的无定形石英粉体材料。本公司利用特殊制备工艺生产的球形二氧化硅粉，具有球形度和球化率极高，纯度高可达电子级，粒度小至亚微米或纳米级别，颗粒分布均匀，无团聚等优点。球形硅微粉作为填充料，可以极大提高电子制品的刚性、耐磨性、耐候性、抗冲击抗压性、抗拉性、耐燃性、耐电弧绝缘特性和抗紫外线辐射的特性。

为使球形硅微粉能更好的应用于环氧模塑料，一般对球形硅微粉产品的粒度分布、化学成分、电导率、pH、球化率和白度等性能参数进行检测，以控制其质量

球化率表示产品中球形颗粒所占比例，球化率越高，球形硅微粉产品在环氧模塑料中的填充性能越好。采用火焰法生产球形硅微粉，影响产品球化率的因素是火焰温度和颗粒的分散程度。火焰温度可通过调节燃气和氧气的流量达到最佳。石英颗粒的分散是生产超细球形硅微粉产品的关键工艺，超细粉体颗粒小，比表面积大，由于静电引力及范德华力极易产生团聚现象。如果在进入球化炉前不解决角形硅微粉团聚问题，多个石英微粒会在火焰中粘结共熔，球化后会形成粒径很大的颗粒，影响产品的质量及产率。可采用高压空气将超细粉体雾化，再进行超声分散，使团聚的原料颗粒解聚，提高球形硅微粉产品的球化率。

*产品特点：

1. 高球形率，粒度分布集中、可高比例填充；
2. 高纯度、高绝缘性、电性能优异；
3. 低膨胀系数、低摩擦系数。

*关键应用：

1. 环氧塑封EMC、环氧浇注、包封料；
2. 高频板、封装基板、高性能覆铜板CCL填料；
3. BOPP、PET、PC等薄膜开口剂；
4. 抗刮擦涂料、粉末涂料外添加剂等。

*技术指标

牌号		SJS-0020	SJS-0030	SJS-0050	SJS-0080	SJS-0100	SJS-0203
粒径 (D50)	μ m	2.5 ± 1	3.5 ± 1	5 ± 1	8.5 ± 1	10 ± 2	11 ± 3
BET比表面积	m ² /g	6 ± 2	—	< 2	—	< 1.5	3.5 ± 1.5
电导率	μ S/cm	20	20	20	20		
密度	g/cm ³				2.2 ± 0.3		
成分	SiO ₂				99.8		
	Al ₂ O ₃			0.08			
PH值	--				6.5 ± 1		
包装	纸塑复合袋				25kg		

*表面处理：为了满足客户对填充量及不同体系分散性能的特殊需求，壹石通可为客户定制不同粒径混配粉、表面特殊化学试剂处理的产品，旨在降低粘度基础上尽可能提升填充率和分散性。